

EDN Taiwan 2026 Editorial Calendar									
期刊	技術主題		趨勢與分析			設計與技術			
	封面特寫	EDN Gallery	EDN評論	技術脈動	工程師訪談	設計解析	e手作	技術縱橫	設計實例
1-3 月刊 廣告預定截止日期：2026年1月20日 材料提交截止日期：2026年1月30日	AI 安全/可信賴運算	•	•	•		•	•	AIoT/Edge AI 安全/可靠性	•AI模型安全/LLM防護/對抗式AI •晶片資安/防竄改/量子加密/PQC •邊緣裝置隱私運算/CPS •工控與半導體資安整合
4-6 月刊 廣告預定截止日期：2026年4月20日 材料提交截止日期：2026年4月29日	電力電子/能源轉型	•	•	•	•	•	•	電力轉換/ 綠色能源	•高功率轉換/能量採集/新能源 •馬達驅動控制/EV電源模組 •智慧電網/儲能管理系統(EMS/ BMS)
7-9 月刊 廣告預定截止日期：2026年7月20日 材料提交截止日期：2026年7月30日	感測器融合/ 嵌入式系統設計	•	•	•		•	•	感測器融合/ 嵌入式AI	•MEMS/感測器整合與模組化 •機器人/無人機/RTOS/RISC-V •Edge AI/TinyML/MCU/MPU •電源管理/低功耗設
10-12 月刊 廣告預定截止日期：2026年10月20日 材料提交截止日期：2026年10月30日	晶片製造與先進封裝	•	•	•	•	•	•	3D IC/Chiplet 異質整合	•Chiplet設計/先進封裝 •封測自動化/熱管理 •晶片互連/高速介面(UCIe/CXL) •設計驗證與良率提升

EDN Taiwan 2026 Editorial Calendar									
Issue	Technical Features		Trends & Analysis			Design & Technology			
	Cover Story	EDN Gallery	Comment	Pulse	EE Life	Teardown	e-DIY	Design Focus	Design Ideas
JAN-MAR Ad Booking Deadline: 20-Jan-2026 Ad Materials Deadline: 30-Jan-2026	AI Security / Trusted Computing	•	•	•		•	•	AIoT / Edge AI Security / Reliability	• AI Model & LLM Security/ Adversarial AI / Anti-Tamper • Chip & Quantum Security / PQC • Edge Device Privacy / CPS • Industrial & Semiconductor Security Integration
APR-JUN Ad Booking Deadline: 20-Apr-2026 Ad Materials Deadline: 29-Apr-2026	Power Electronics / Energy Transition	•	•	•	•	•	•	Power Conversion / Green Energy	• High-Power Conversion & Energy Harvesting / New Energy • Motor Drive & EV Power • Smart Grid / Energy Storage Management Systems (EMS/BMS)
JUL-SEP Ad Booking Deadline:20-Jul-2026 Ad Materials Deadline: 30-Jul-2026	Sensor Fusion / Embedded System Design	•	•	•		•	•	Sensor Fusion Embedded AI	• MEMS & Sensor Modularization • Robotics / UAV & RTOS / RISC-V • Edge AI/TinyML & MCU/MPU • Power Mgmt / Low-Power Design
OCT-DEC Ad Booking Deadline: 20-Oct-2026 Ad Materials Deadline: 30-Oct-2026	Chip Manufacturing & Advanced Packaging	•	•	•	•	•	•	3D IC / Chiplet Heterogeneous Integration	• Chiplet & Advanced Packaging • T&M Automation / Thermal Mgmt • Chip Interconnect / High-Speed Interfaces (UCIe / CXL) • Design Verification & Yield